銅表面 Cu(111)上の NO の拡散メカニズム : DFT モデル計算によるアプローチ

 $(北大院工^1 \cdot 京大VBL^2)$ 井山 哲 L^1 ,川畑 L^2 ,田地川 浩 L^1

【序】

銅触媒は、吸着した一酸化窒素分子の電子状態を著しく活性化し、効率よく還元することができる触媒として知られている。そのため、銅-NOの相互作用について、HREELS、2フォトンエミッション、およびシンクロトロンIR等により、古くから多くの実験が行われている。これまでの研究により、NOと Cu が相互作用することにより、メタルから NO分子の π * 軌道への電子の移動が起き、N-O 結合が弱くなり、その結果、NOが活性されると考えられているが、その詳細なメカニズムについては、まったくわかっていない。また、理論計算からのアプローチでは、銅の単原子モデルが使用されており、大きいクラスターと NOの相互作用については、ほとんどわかっていない。

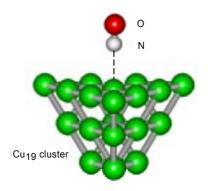
本研究では、銅クラスターに吸着したNO分子の電子状態を密度汎関数法により計算し、 その相互作用について、理論的解明を試みた。また、モデルクラスター表面でのNO分子の 拡散過程のメカニズムについて考察した。

【計算方法】

Cu 原子 9 個および 19 個からなるモデルクラスターモデルにより、Cu(100)面および Cu(111)面モデルを構築し、その表面の中心銅原子へ NO 分子を吸着させ、NO と銅表面との相互作用を理論的に解明した。計算はすべて、B3LYP/LANL2DZ レベルの DFT 計算により行った。¹⁾ また、拡散のメカニズムを明らかにするため、Cu(100)面について、2 つの拡散経路を、Cu(111)面については 3 つの拡散経路を、それぞれ考慮し、NO 吸着および拡散のポテンシャルエネルギーカーブを計算し、拡散過程の理論的解明を行った。

【結果と考察】

NO の吸着構造および吸着による電子構造の変化を求めるため、Cu 原子 9 個および 19 個からなる銅クラスターに NO を吸着させ、その構造を最適化した。その吸着構造を Figure 1 に示す。 Cu_9 への吸着の場合、表面から、1.921Åの位置に、Cu-N-O角=122.6度のベント構造で吸着した。



 \boxtimes 1. Optimized structure of NO on Cu₁₉ surface calculated at the B3LYP/6-311G(d,p) level.

また、NO の原子間距離は、吸着前と後で、1.148 A から 1.179 A へ、わずかに伸びた。吸着後の N および 0 原子の電荷は、-0.27 および-0.13 となり、Cu 表面への吸着により NO 分子は、およそ-0.40 の負の電荷を持つことが示された。これは、Cu から NO 分子の π *軌道に電子の back-donation が起こるためであり、これまでの実験からの予測を支持するものである。

計算の結果、吸着サイトとして、2-fold、4-fold、および On-top サイトの3つの吸着サイトが存在することが、明らかになった。それぞれのサイトへのNOの吸着エネルギーは、8.3、13.1、および12.1 kcal/mol であり、2-fold サイトが最も安定なサイトであった。

比較のため、Cu 原子 1 つに吸着した NO 分子 (すなわち、Cu-NO binary complex)について、構造最適化を行い、各原子の電荷を計算した。その結果、Cu、N および 0 原子の電荷は、それぞれ、-0.11, -0.15, および+0.26 となり、Cu のクラスター (Cu) の場合と、電荷の分布が大きく異なること結果が得られた。このことは、Cu 単原子と NO の相互作用モデルは、表面相互作用を直接反映してないことを示している。

銅モデルクラスター上での NO 分子の拡散メカニズムを明らかにするため、Cu(100)面について、NO 分子の拡散の活性化エネルギーを計算した。拡散経路として、2-fold On-top 2-fold サイトへの経路(Path-a) および、4-fold On-top 4-fold サイトへの拡散経路(Path-b)の二つの経路を取り扱った。その結果、Path-a および Path-b についての拡散の活性化エネルギーとして、それぞれ、4.8kcal/mol および 8.8 kcal/mol が得られた。また、Cu(111)面においては、8.3 kcal/mol と求められた。拡散のメカニズムについて、議論する。

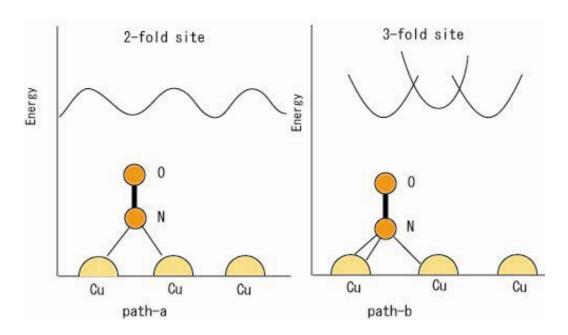


Figure 2. Model of the diffusion of NO on Cu(100) surface.

-

¹⁾ H. Tachikawa, T. Iyama, and H. Kawabata, J. Mol. Struct. (THEOCHEM), 718, 117-122 (2005)